

NUMBER 316516

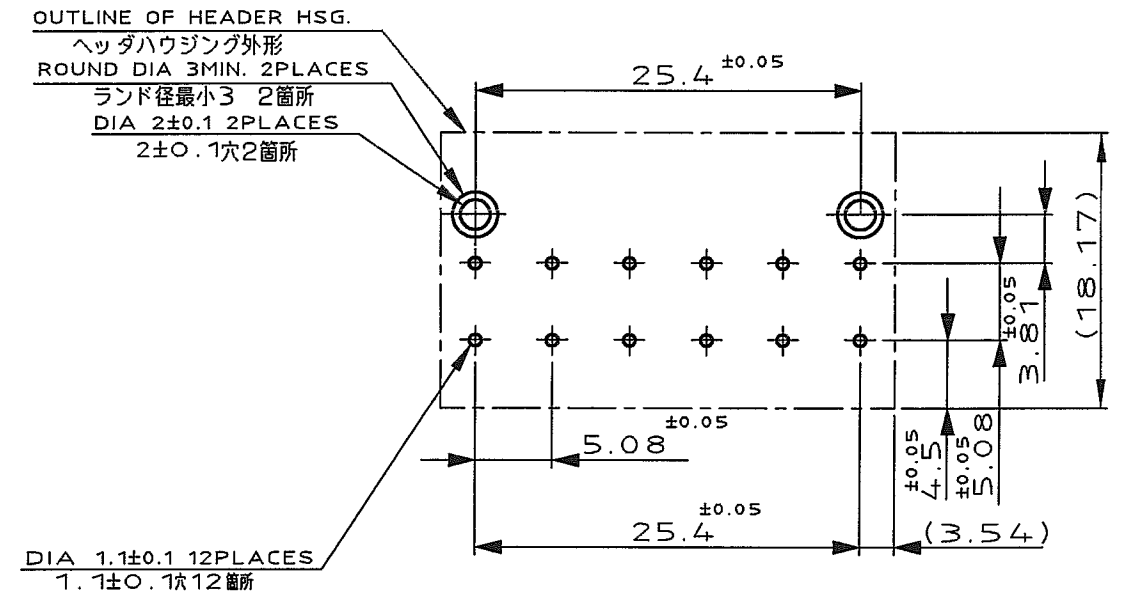
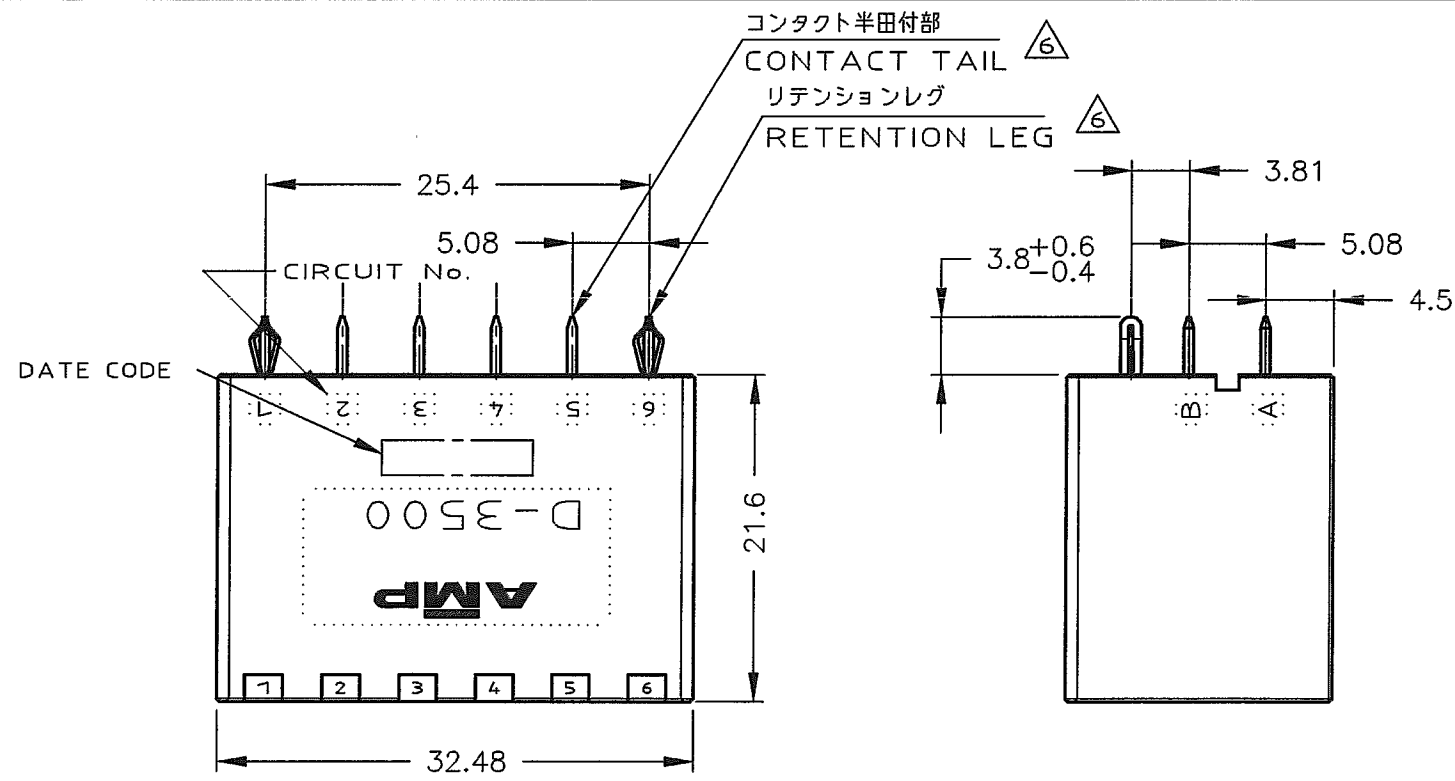
METRIC

PROJ NO.395-623

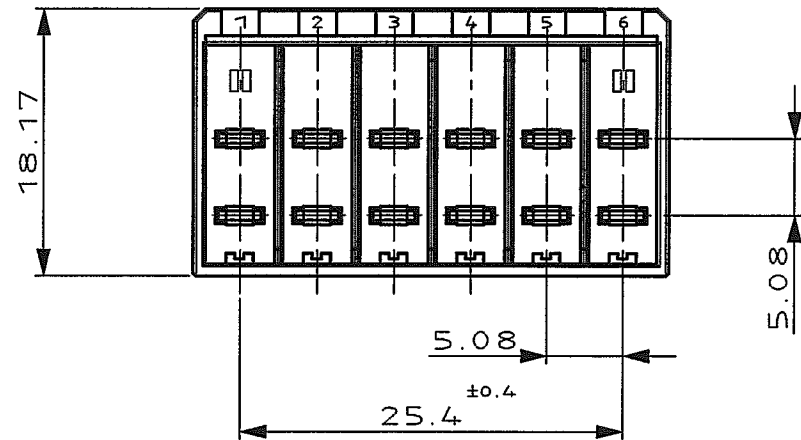
単位: 寸法 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J REV.10/83



推奨基板取付け寸法 (非累積公差)  
RECOMEND PC BOARD HOLE (NOT ACCUMULATE TOLERANCE)  
PC BOARD THICKNESS;1.6±0.1  
基板厚;1.6±0.1



NOTES

- MATERIAL:HOUSING:GLASS FILED THERMO PLASTIC,UL94V-0  
CONTACT:COPPER ALLOY  
RETENTION LEG:COPPER ALLOY
- FINISH(CONTACT AREA):0.38μmMIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH(CONTACT AREA):0.76μmMIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH(CONTACT AREA):2.0 μmMIN TIN PLATED OVER NICKEL
- FINISH(RETENTION LEG):~~TIN-LEAD PLATED~~ (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- FINISH(RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注記

- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性樹脂,UL94V-0  
コンタクト: 銅合金  
リテンションレグ: 銅合金
- めっき: コンタクト接触部: ニッケル下地の上に金めっき0.38μmMIN
- めっき: コンタクト接触部: ニッケル下地の上に金めっき0.76μmMIN
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地接触部: 2.0 μm MINスズめっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部: ニッケル下地の上に半田めっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部: ニッケル下地の上にスズめっき

△6	△4	-5
△6	△3	-3
△6	△2	316516-2
FINISH	型番	PART NUMBER

Copyright ©1995 年		Copyright ©1995		tyco Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
材料(MATERIAL) (SEE NOTE)		社上(FINISH) (SEE NOTE)		名称(NAME) DYNAMIC(D-3500) 12 POS. V HDR. ASS'Y	
DR. 24 OCT 95 N.MATSUBARA		DE. 24 OCT 95 N.MATSUBARA		一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	
CHK. Y.ISHIKAWA		APP. 24 OCT 95 S.MANABE		10mm下 ±0.35 10mm上 3mm下 ±0.4 30mm上100mm下 ±0.45 角 度 ±3'	
LTR 変更 (REVISION RECORD)		DR CHK DATE		A3 J 番号(No.) C=316516	
				尺貫(SCALE) 2/1 REV. B SHEET 1 OF 1	

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>TE Connectivity\(泰科\)](#)